

厦门金圆投资集团有限公司

2021 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）

发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担相应责任。

厦门金圆投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向专业投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕2424 号”文注册。

根据《厦门金圆投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》，厦门金圆投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），本期债券分为两个品种，品种一为 3 年期，品种二为 5 年期。发行价格为每张人民币 100 元，采取网下面向专业投资者公开发行的方式发行。

本期债券发行时间自 2021 年 10 月 18 日至 2021 年 10 月 19 日，品种一发行规模为 10 亿元，票面利率为 3.40%；品种二发行规模为 5 亿元，票面利率为 3.87%。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《厦门金圆投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



(本页无正文，为《厦门金圆投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行
科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)

牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人：中信证券股份有限公司



（本页无正文，为《厦门金圆投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司



2021年10月19日

（本页无正文，为《厦门金圆投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：海通证券股份有限公司



2021年10月19日

（本页无正文，为《厦门金圆投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：金圆统一证券有限公司

